

杭州士兰微电子股份有限公司

2019 年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 公司预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 11,932 万元到 15,341 万元，同比减少 70%到 90%。
2. 预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少 13,852 万元到 17,261 万元，同比减少 154%到 193%。

一、 本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

- 1、经公司财务部门初步测算，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 11,932 万元到 15,341 万元，同比减少 70%到 90%。
- 2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少 13,852 万元到 17,261 万元，同比减少 154%到 193%。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：17,046.26 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,965.64 万元。

（二）每股收益：0.13 元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）主营业务影响

作为 IDM 公司，公司带有资产相对偏重的特征，2019 年公司受全球半导体行业增速放缓、产品研发和生产投入增加等因素的影响，公司经营业绩较上年同期出现了较大幅度的下降，具体原因如下：

1、子公司杭州士兰集成电路有限公司部分境外客户订单数量减少，导致 5 吋线产能利用率下降，加之硅片等原材料成本在上半年处于历史高位，以及对汽车级功率模块产品研发等投入进一步加大，导致经营利润较上年同期下降较多。

2、子公司杭州士兰集昕微电子有限公司 8 吋芯片生产线仍处于特色工艺平台的建设阶段，对高端功率器件的研发投入较上年同期有较大幅度的增加，加之 2019 年前三季度士兰集昕主动调整了生产线上产品的结构，减少了低附加值产品的产出量，故导致士兰集昕亏损数额较上年同期加大。

3、受 LED 行业波动的影响，子公司杭州士兰明芯科技有限公司发光二极管芯片价格较上年同期下降了 20-30%，加之士兰明芯加大了对第三代化合物半导体器件、高端 LED 芯片等产品的研发投入，导致其亏损进一步增加。

4、参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司加快推进项目建设，人员支出等管理费用较上年同期增加较多，导致其亏损进一步增加。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计。公司基于自身专业判断进行初步测算，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日